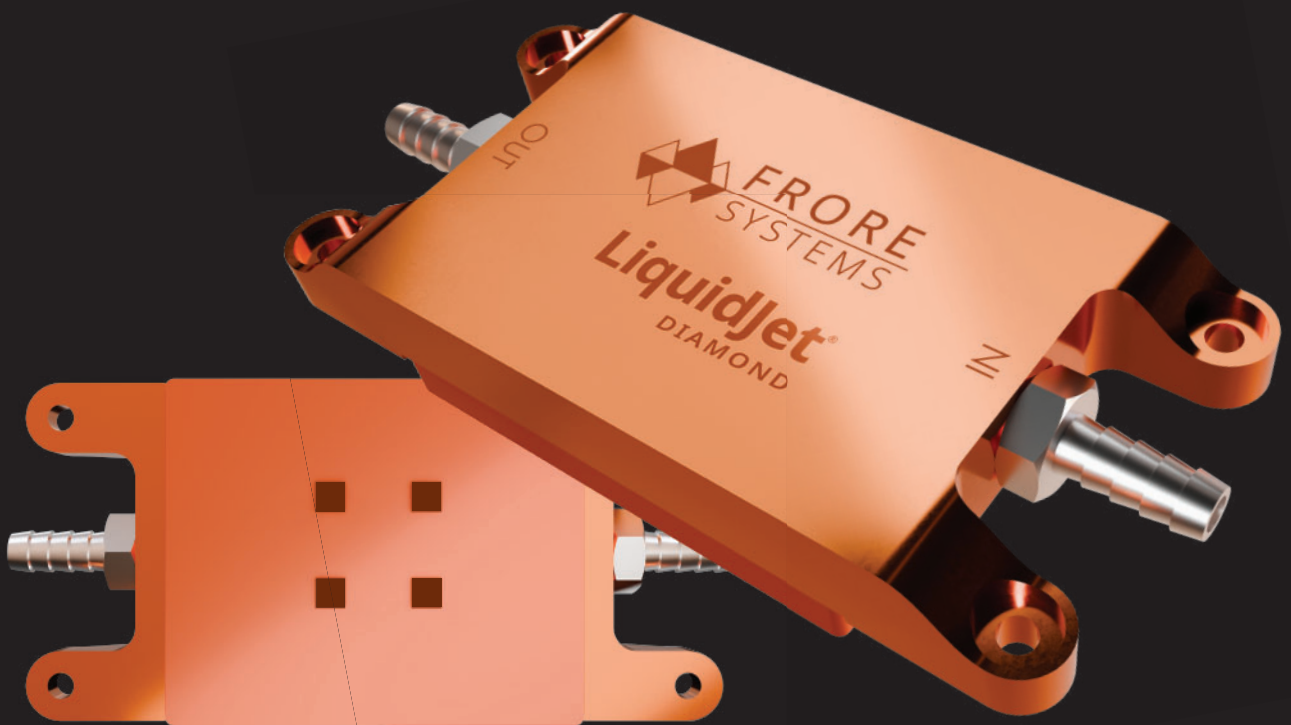




Do More.



LiquidJet® DIAMOND

面向高功率密度热点的最先进 DLC 冷板

LiquidJet® DIAMOND

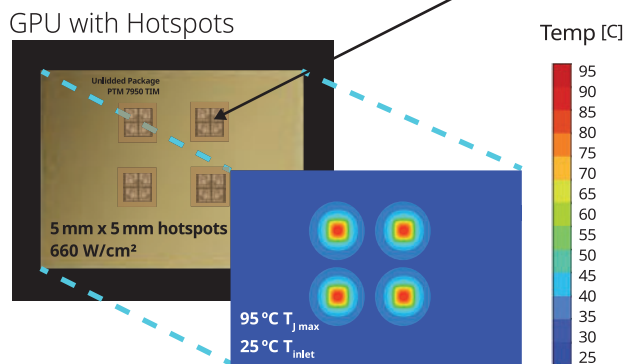
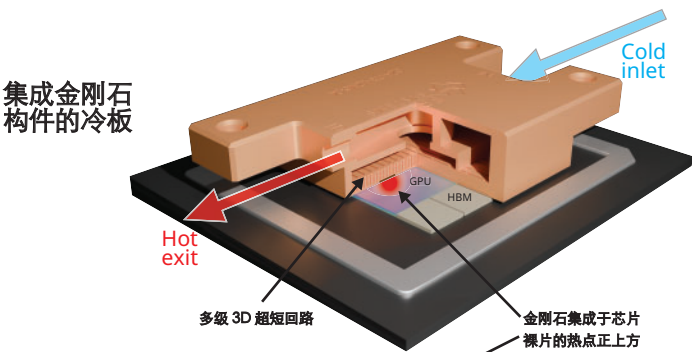
面向高功率密度热点的最先进 DLC 冷板

产品描述：

LiquidJet DIAMOND 是一款集成金刚石均热结构的 3D 超短回路多级冷板。LiquidJet DIAMOND 采用创新的多级架构，旨在实现比传统铲削冷板高出 120% 的性能，同时将换热效率提升 75%。该设计可将全部流体集中于热点区域，优先对热点进行冷却，随后再对 GPU 裸片、高带宽内存 (HBM) 以及 SoC 中的其他芯片区域进行散热。在进水温度 25°C、采用 PTM7950 导热界面材料 (TIM) 和裸封装的条件下，LiquidJet DIAMOND 可支持 5 mm × 5 mm 热点区域高达 660 W/cm² 的散热能力， T_{jmax} 为 95°C，其散热能力超过 Rubin Ultra、Feynman、MI455、MI500 等未来 GPU 以及超大规模云服务商定制 ASIC 的散热需求。

集成金刚石的 3D 微结构核心：

Fröre Systems 采用独特的 LiquidJet 冷板制造工艺，将半导体制程应用于金属晶圆，构建采用创新 3D 超短回路的多级冷却架构，并依据数据中心 GPU 的功耗分布图进行精准设计。金刚石嵌入冷板底面，直接布置于芯片热点的正上方。



LiquidJet DIAMOND 与多入口铲削冷板的性能对比：

- 热点冷却：最大功率密度提升 120%
- 换热效率提升 75%
- GPU 温度降低 12-18°C
- 每瓦功耗 AI 词元输出提升 20-35%
- 无缝替换升级

规格参数：

LiquidJet DIAMOND 的所示尺寸为针对目标 GPU 的定制版本。

基于 NVIDIA GB300 测试

长：104.6 mm 宽：62 mm 高：20.4 mm

材质：铜、金刚石

